

ウェーハ研削の課題解決を提案します

提供晶圆磨削课题的解决方案



ウェーハ研削用
8インチ・6インチ SiCウェーハ 他
晶圆磨削用 8英寸、6英寸SiC晶圆等

NEW!

ビトリファイドダイヤモンドホイール

玻璃化金刚石砂轮 nanoVi®

nanoVi®

粗加工 粗加工

工具寿命を延ばしたい
希望延长工具寿命

**高強度ガラス結合剤による
ホイール耐摩耗性の向上**

通过高强度玻璃结合剂，
提高砂轮耐磨损性

8インチ（レーザー切断面）
SiCウェーハにおいて

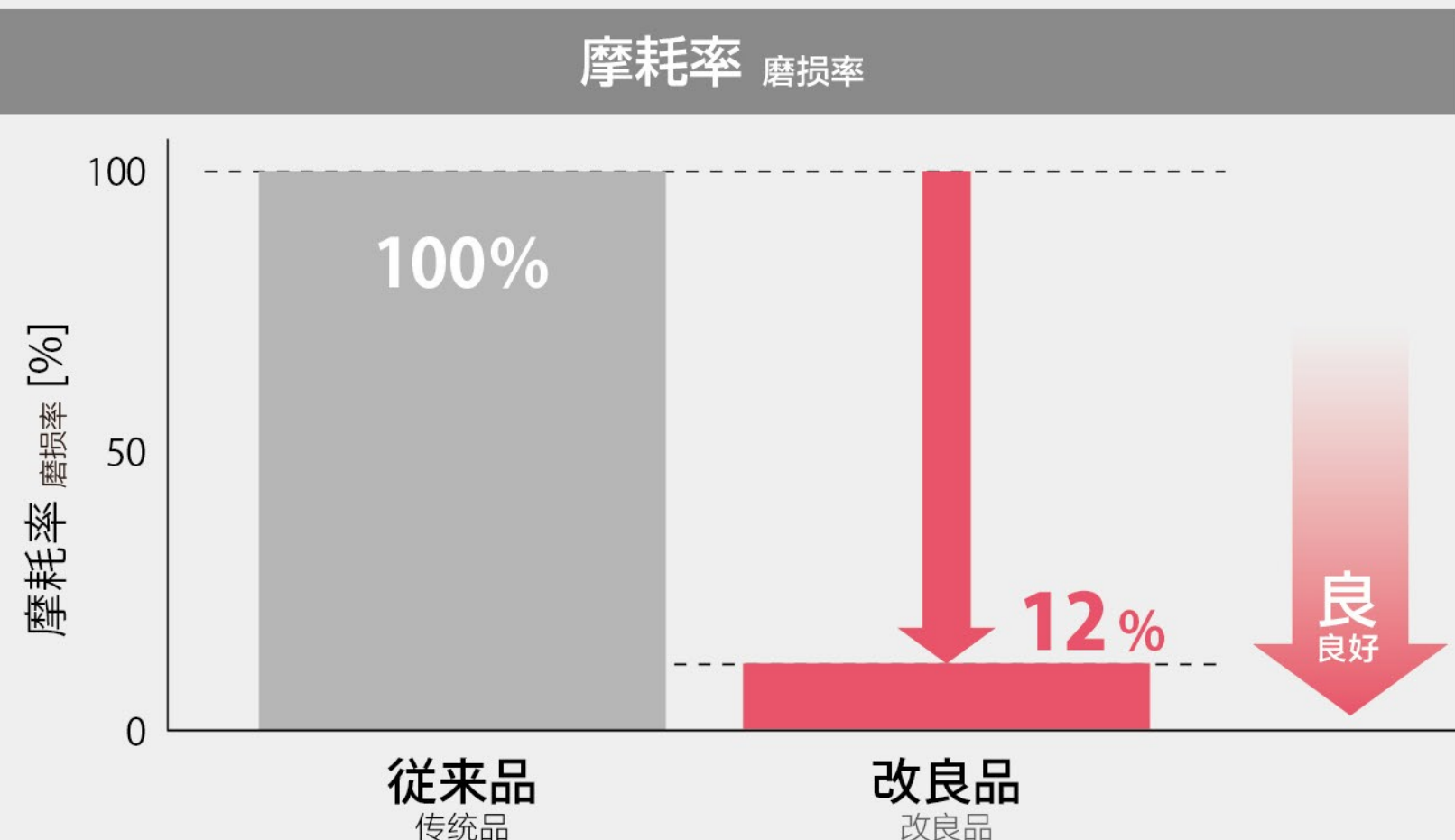
摩耗率 12% 達成

8英寸（激光切割面）SiC晶圆的
磨损率达到12%

評価事例
评估示例
(SD2000)

送り速度
进给速度

0.5 $\mu\text{m}/\text{sec}$



仕上げ加工 精加工

加工品質を安定させたい
希望稳定加工质量

**均一なホイール組織による
砥粒分散性の向上**

通过均匀的砂轮组织，
提高磨粒分散性

8インチ
SiCウェーハにおいて
**連続研削でも
安定した表面品位**

8英寸SiC晶圆的
连续磨削也能获得稳定的表面品位

評価事例
评估示例
(SD30000)

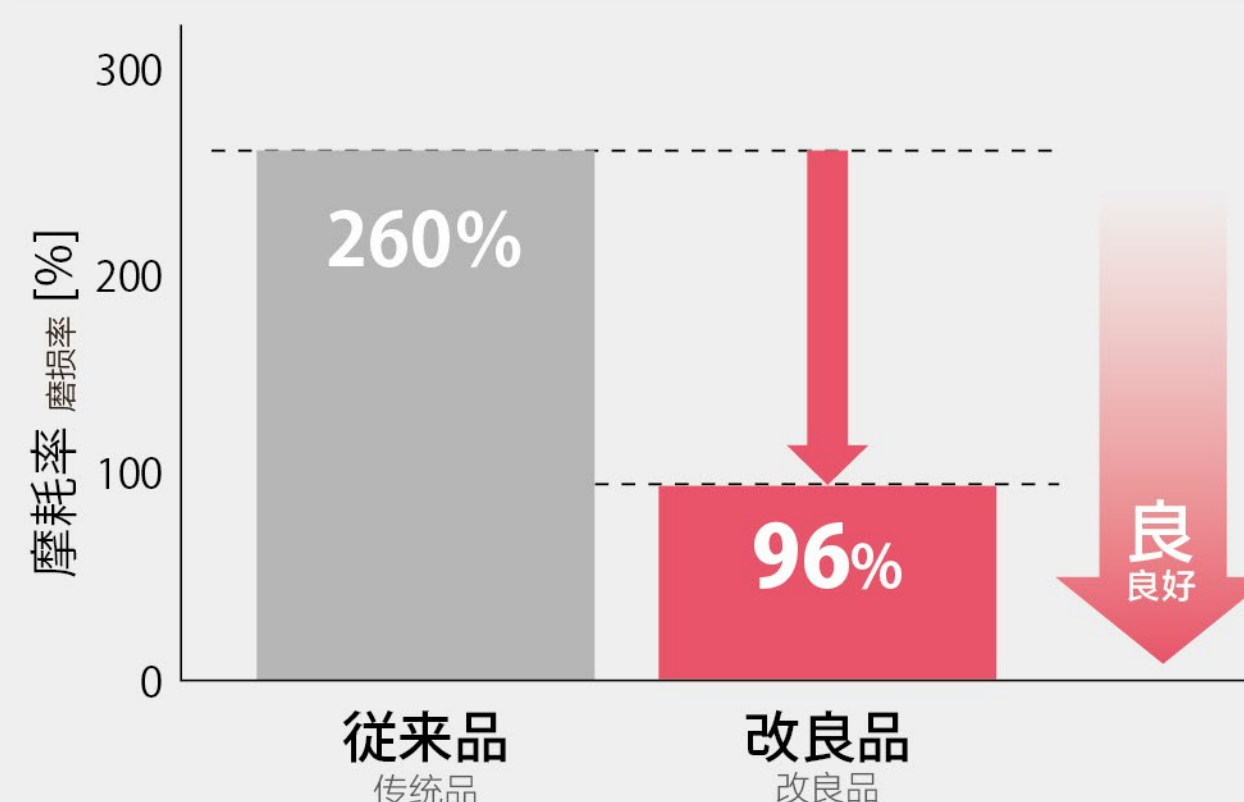
送り速度
进给速度

0.2 $\mu\text{m}/\text{sec}$

表面あらさ
表面粗度

**Sa 2nm
以下**

摩耗率 磨损率



当社は「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション (TPEC)」に参加し協業で本開発を実施しました
本公司参与“Tsukuba Power-Electronics Constellations (TPEC)”并合作进行了此项开发。

